

Die ITG

Die Informationstechnische Gesellschaft im VDE (ITG) wurde 1954 vom VDE gegründet. Sie hat die Aufgabe, die wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen in der Informationstechnik und ihre Anwendungen zu fördern, den dazu erforderlichen Dialog zwischen Hochschulen, Herstellern und Anwendern in der Informationstechnik zu initiieren, die beruflichen Interessen der auf dem Gebiet der Informationstechnik tätigen Ingenieure und Wissenschaftler zu vertreten und ein Forum für die Diskussion dieser Techniken in der Öffentlichkeit zu bilden.

Die Aktivitäten der ITG beziehen sich sowohl auf den technisch-wissenschaftlichen Bereich in Entwicklung und Fertigung als auch auf Fragen des immer bedeutenderen und aktueller werdenden Technologietransfers, der Aus- und Weiterbildung, des Arbeitsmarktes und nicht zuletzt der Öffentlichkeitsarbeit. Die ITG führt hierzu u. a. Fachtagungen, Diskussionssitzungen und Workshops durch. Sie gibt die Nachrichtentechnische Zeitschrift - und zusammen mit der GMM - die Zeitschrift "Mechatronik" heraus und vergibt eine ganze Reihe von Preisen für wissenschaftliche Leistungen und herausragende Veröffentlichungen.

Die ITG hat z.Zt. 11000 Mitglieder und 1400 ehrenamtliche Mitarbeiter. Die fachliche Arbeit vollzieht sich in 9 Fachbereichen mit ca. 40 Fachausschüssen und 60 Fachgruppen.

Themenschwerpunkte sind:

- Dienste und Anwendungen
- Fernsehen, Film und Elektronische Medien
- Audiokommunikation
- Kommunikationstechnik
- Technische Informatik
- Hochfrequenztechnik
- Mikro- und Nanoelektronik

Veranstalter

Der Workshop wird von der ITG Fachgruppe 5.3.2 "Photonische Komponenten und Mikrosysteme" in Zusammenarbeit mit der TU Dresden veranstaltet.

Mitglieder der ITG-Fachgruppe 5.3.2

Prof. Dr. Manfred Berroth, Universität Stuttgart

Prof. Dr. Jörg Franke, Universität Erlangen

Prof. Dr. Ulrich Fischer-Hirchert, Hochschule Harz, Wernigerode

Dipl.-Ing. M. Franke, Siemens AG, Berlin

Dr. Norbert Grote, Fraunhofer HHI Berlin

Dipl.-Ing. Lutz Melchior OptriCon GmbH, Berlin

Richard Pitwon, XyrATEX Ltd., Havant, United Kingdom

Dr. Marc Schneider, KIT, Karlsruhe

Dr. Henning Schröder, Fraunhofer IZM, Berlin

Dr. Klaus Schulz, Sodaja Consulting, Berlin

Dr. Krzysztof Nieweglowski, TU Dresden

Dipl.-Phys. Andreas Umbach, u2t Photonics AG, Berlin

Organisationsbüro:

Technische Universität Dresden

Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik
Institutsdirektor: Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus-Jürgen Wolter
D - 01062 Dresden

Ansprechpartner:

Dr. Krzysztof Nieweglowski

Technische Universität Dresden,

Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Fon: +49 - 351 - 4633 5291

Fax: +49 - 351 - 4633 7035

nieweglowski@avt.et.tu-dresden.de

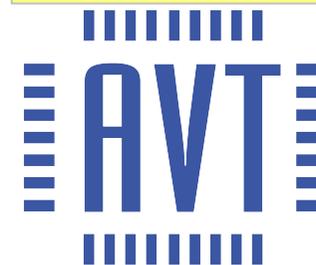
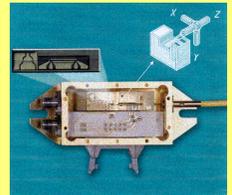
ITG INFORMATIONSTECHNISCHE
GESELLSCHAFT IM VDE



11. ITG-Workshop

Photonische Komponenten und Mikrosysteme

**11. Juli 2013
in Dresden**



VDE

Einladung zum 11. ITG-Workshop "Photonische Komponenten und Mikrosysteme"

Die Informationstechnische Gesellschaft im VDE vertreten durch die [ITG-Fachgruppe 5.3.2](#) „Photonische Komponenten und Mikrosysteme“ und die TU Dresden werden am **11. Juli 2013 von 10-17:00** einen Workshop ausrichten, zu dem wir interessierte Experten aus Wissenschaft und Industrie herzlich einladen. International angesehene Experten der Branche werden über zukünftige Trends und Entwicklungen im Bereich der photonischen Komponenten und deren Aufbautechnik im Bereich des **Photonic μ -Packaging** berichten.

Der Workshop findet in Dresden am 11. Juli 2013 statt.

PKM-Workshop-Programm

Photonic μ -Packaging

Moderation: Ulrich Fischer-Hirchert, HS Harz, Wernigerode

09.50-10.00 **Begrüßung Prof. Wolter**, IAVT, TU Dresden

10.00-10.25 **Impulsvortrag**

Angefragt Markus Detert, Otto von Guericke Universität Magdeburg

10.25-10.50 **Photonik aus Berlin: Ergebnisse aus dem Förderprojekt PolyBoard**

Norbert Grote, Fraunhofer HHI Berlin

10.50-11.05 **Integrierte optische Polymer-Komponenten für WDM over POF**

Sebastian Höll, HS Harz

11.05-11.45 Kaffeepause

11.45-12.10 **Titel offen**

Michael Scholles, Fraunhofer IPMS

12.10-12.35 **Titel offen**

Sebastian Löffler, RHe Microsystems GmbH

12.35-13.00 **Compact filter structures in Silicon-on-Insulator for high-speed signal processing**

Stefan Schwarz, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg

13.00-14.00 Mittagspause

14.00-14.25 **Automated Packaging of Photonic Communication Transceivers**

Gunnar Böttger, Fraunhofer IZM Berlin (OIT)

14.25-14.50 **μ -Packing - Challenge to go Green**

Klaus Schulz, sodaja Consulting

14.50-15.05 **Miniaturisierung von optischen Empfängermodulen für hochfrequente Anwendungen**

Gerald Jacumeit, Christoph C. Leonhardt u2t Photonics AG Berlin

15.05-15.45 Kaffeepause

15.45-16.10 **Kleben in der Optoelektronik**
Rainer Dörfler, DELO Industrie Klebstoffe

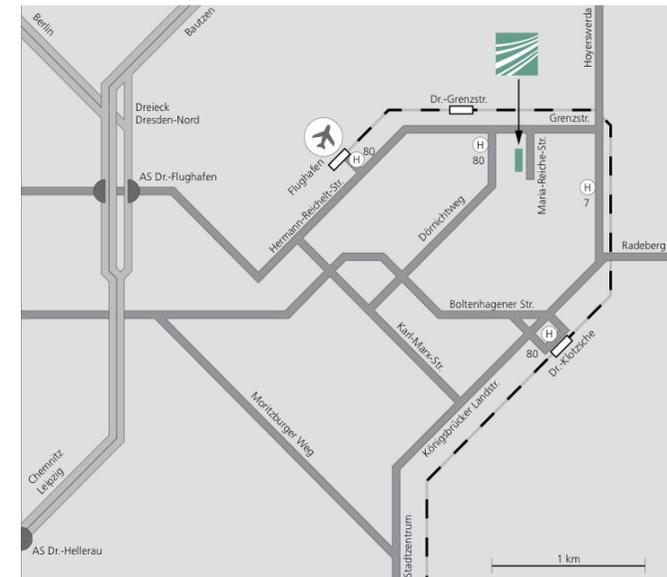
16.10-16.35 **Automatisiertes Packaging von Lasermodulen**

Angefragt Torsten Vahrenkamp ficonTEC Service GmbH

16.35-17.00 **Zusammenfassung und Abschluss**

Die Tagung findet statt:

Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP
(Standort Dresden)
Raum Fraunhofer (4.016)
Maria-Reiche-Straße 2
01109 Dresden



Hotelinformationen finden Sie im Internet unter:

<http://www.dresden.de/touristischer-marktplatz/onlinebuchung-unterkuenfte>

Gästehäuser der TU-Dresden:

<http://tu-dresden.de/service/gaestehauser>